

書籍・調査レポート申込書

CMC リサーチ発行

「半導体パッケージの最新技術動向と半導体封止材の設計・評価技術」

発行：2026年1月30日 体裁：A4判 並製 121頁

ご注文：□ 本体（冊子版） 88,000円（税込） □ 本体+CD（PDF版） 110,000円（税込）

送信先 **Fax：03-3291-5789**

CMC リサーチ TEL：03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住所2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	☐ 受信する ☐ 受信しない
DM（郵便など）受け取り可否	☐ 受け取る ☐ 受け取らない
興味分野	
お支払い（銀行振込） 予 定 日	年 月 日頃
通 信 欄	